

中信建投证券股份有限公司
关于强一半导体（苏州）股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告

| | |
|--------------------|--|
| 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：强一半导体（苏州）股份有限公司 |
| 保荐代表人姓名：郭家兴 | 联系方式：010-85156367 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康大厦 |
| 保荐代表人姓名：张宇辰 | 联系方式：010-65608358 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康大厦 |

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609 号），并经上海证券交易所同意，强一半导体（苏州）股份有限公司（简称“强一股份”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）3,238.9882 万股，每股发行价为人民币 85.09 元，募集资金总额 275,605.51 万元，扣除发行费用 22,959.33 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 252,646.18 万元。本次公开发行股票于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”、“保荐人”）担任本次公开发行股票保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 |
|----|---|---|
| 1 | 保荐机构、保荐代表人应当协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和本规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员知晓其在本规则下的各项义务。 | 保荐人、保荐代表人已协助和督促强一股份建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，符合法律法规和本规则的要求。强一股份及其实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员已知晓其在本规则下的各项义务。 |
| 2 | 保荐机构、保荐代表人应当持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 保荐机构、保荐代表人应当对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。 | 保荐人、保荐代表人已持续督促强一股份充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，强一股份信息披露真实、准确、完整、及时、公平。保荐人、保荐代表人已对强一股份制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。保荐人、保荐代表人已督促强一股份实际控制人 |

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 |
|----|---|---|
| | 保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。 | 履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助强一股份隐瞒重要信息。 |
| 3 | 上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、本规则以及本所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。 | 保荐人、保荐代表人已督促强一股份、实际控制人对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐人、保荐代表人已针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，并督促相关主体及时、充分履行承诺。 2025年度，强一股份或其实际控制人承诺履行情况良好，符合法律法规、相关规则以及交易所有关规定。 |
| 4 | 保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。 | 保荐人、保荐代表人已督促强一股份积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。 |
| 5 | 保荐机构、保荐代表人应当持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项。 保荐机构、保荐代表人应当核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。披露内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，保荐机构、保荐代表人应当发表意见予以说明。 | 保荐人、保荐代表人持续关注强一股份运作，对强一股份及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料等方式，关注强一股份日常经营和股票交易情况。报告期内，强一股份不存在重大风险或重大负面事项。 |
| 6 | 上市公司股票交易出现严重异常波动的，保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司及时按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行信息披露义务。 | 强一股份于2025年12月30日上市，2025年度股票交易未出现严重异常波动。 |
| 7 | 保荐机构、保荐代表人应当督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。 | 保荐人、保荐代表人已督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺。2025年度，前述主体未减持公司股份。 |
| 8 | 保荐机构、保荐代表人应当关注上市公司使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。 | 保荐人、保荐代表人已关注强一股份使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。 |

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现强一股份存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

报告期内，公司向前五大客户销售金额占营业收入的比例为 76.93%，客户集中度相对较高。若下游行业景气度发生波动、主要客户自身经营状况或采购计划发生重大变化，将可能对公司营业收入及盈利能力产生直接影响。

公司所处半导体测试行业技术迭代速度较快，下游芯片制程升级、产品更新换代频繁，对探针卡产品的技术指标、测试精度、稳定性及高频高速性能要求持续提升。若公司未能持续跟进技术发展趋势、及时研发并推出符合客户新一代芯片测试要求的产品，无法持续满足核心客户的测试需求，可能导致客户订单减少、销售收入下滑，进而对公司经营业绩产生不利影响。

同时，公司核心客户所处产业链环节较多，若其芯片设计、晶圆制造、封装测试等任一关键环节受到外部环境变化或产业政策调整影响，导致出货量及产能利用率下降，亦将相应减少对公司探针卡产品的采购需求，从而对公司经营业绩构成压力。

尽管公司持续优化客户结构、积极拓展新客户与新应用领域，但受下游行业市场格局、产品验证周期较长等因素影响，预计未来一定时期内客户集中度仍可能处于相对较高水平。若未来公司与主要客户合作关系发生不利变化，或下游行业及市场环境出现重大波动，将可能导致公司订单减少、营收及利润下滑，进而存在业绩大幅下滑的风险。

（二）技术泄露与人员流失风险

探针卡行业属于智力密集型行业，管理团队、研发团队和生产技术团队是保持公司持续经营能力、技术创新能力、产品交付能力的核心资源。相关人员在具备必要的知识、充分的理论的基础上，还需要丰富的实践经验、强大的执行能力。核心技术人员若流失或技术泄露将影响研发能力。

探针及探针卡的设计与制造涉及多学科交叉技术（机械/材料/光电等），对人才的专业水平要求较高，复合型人才培养周期长。但由于我国探针卡产业起步较晚且属于相对细分行业，目前国内院校对探针卡专业人才的培养不足，有丰富实践经验的人才也较为缺乏。随着行业快速发展，高端人才供需缺口进一步扩大。公司采用多种策略招聘探针卡高端人才，但仍不足以满足公司不断增长的研发需求。

（三）技术迭代风险

探针卡是晶圆测试设备与待测晶圆之间的必要媒介，实现芯片与测试设备的信号连接。随着芯片性能的不断发展和晶圆测试要求不断提升：更为极端的电气性能、显著减小的接触焊盘间距、不断增加的接触焊盘密度、更严苛的机械精度、更极限的工作温度、更紧凑的生产周期、同时测试多个芯片的高并行性以及更便捷的维修和维护等。探针卡相关技术亦不断随之发展，逐步由传统机械加工方式发展为综合了先进激光技术和光刻工艺以构建微米尺寸零部件的 MEMS 工艺。经过持续的研发投入、自主创新和技术积累，公司在探针卡所需关键环节形成了专业技术能力。截至报告期末，公司累计获得各类知识产权 195 项，其中发明专利 78 项，实用新型专利 107 项，美国专利 6 项，商标 4 项。若公司技术未能紧跟如先进制程和先进封装等半导体技术的发展，公司产品竞争力将有下降的风险。

（四）供应商集中度较高风险

报告期内，公司向前五大供应商采购金额为19,628.94万元，占年度采购总额 62.07%，供应商集中度相对较高，主要系采购探针卡所需的 PCB、MLO、贵金属试剂、探针及机械结构部件等核心原材料；同时，公司设备供应商集中度亦较高。

由于部分原材料、设备的稀缺性，公司存在向单一或少数供应商采购金额占同类原材料、设备采购金额比重较高的情形。公司系综合考虑供应商产品质量、合作历史以及交期等，基于最大限度保证产品交付的稳定性、及时性，采取同种原材料、设备主要通过单一或少数供应商采购的经营策略。目前公司多项核心原材料、专用设备的供应主体以境外厂商及其境内分支机构为主，国内可替代合格供应商储备相对有限。若未来公司与核心供应商合作关系发生不利变动、供应商自身经营及交付能力出现重大波动，或受国际经贸环境变化、供应链阻断等因素影响导致供货受限，而公司短期内难以完成供应商替代与供应链切换，将对公司生产经营、产品交付及经营业绩产生重大不利影响。

（五）市场拓展不及预期

公司目前主要收入来源于境内市场，若未来境内市场需求波动、行业竞争加剧，将对公司经营业绩产生不利影响。同时，公司正在积极拓展境外市场、新产品市场及新客户群体，但境外市场拓展、新产品推广及客户认证均存在一定不确定性，若未来市场拓展不及预期，将对公司未来经营业绩产生不利影响。

（六）产品质量风险

半导体产业链对供应商产品精度、稳定性及可靠性要求严苛。探针卡产品本身设计复杂度高、制造工艺流程精细，且行业技术持续迭代升级。若公司在生产过程中出现设计偏差、原材料性能异常、零部件规格不达标、生产环境温湿度波动影响工艺稳定性及生产设备异常等情形，均可能导致产品性能不符合客户测试标准，进而产生产品质量缺陷。前述情形将对产品交付进度造成不利影响，甚至引发客户订单流失、合作关系波动，并对公司市场声誉、经营业绩及持续经营能力产生负面影响。

（七）经营业绩季节性波动

报告期内，公司营业收入保持快速增长，但受下游半导体行业客户采购计划、项目验收节奏及市场需求波动等因素影响，公司经营业绩存在一定季节性特征。2023-2025年度，公司第四季度营业收入占全年营业收入的比例分别为 49.72%、39.18%和 36.07%，第四季度收入占比相对较高。

由于上述季节性特征，公司不同季度的经营业绩可能存在波动，提醒投资者不宜以单季度经营数据简单推算公司全年经营业绩，避免对公司经营状况产生误判。

（八）关联交易风险

报告期内，公司存在一定金额的关联销售及关联采购，关联交易金额相对较高。公司部分关联方系基于实质重于形式原则认定，相关交易均基于正常商业需求开展，定价公允。

若未来公司关联交易决策程序、定价公允性不能持续保持规范，或关联交易规模、占比进一步上升，可能对公司独立性、经营稳定性产生不利影响。同时，若关联方经营状况发生重大变化，也可能对公司业务、财务状况产生一定风险。

（九）毛利率下降的风险

报告期内，受益于国产替代进程加快、高毛利 MEMS 探针卡收入占比提升等因素，公司综合毛利率提升至 65.03%，高于同行业可比公司平均水平。由于公司 MEMS 探针卡收入占比已显著高于全球行业平均水平，未来继续提升空间相对有限。若未来市场竞争加剧、下游需求波动、原材料价格上涨、产品良率提升不及预期，或公司无法持续保持产品竞争力与成本优势，可能导致公司毛利率出现下滑，进而对经营业绩产生不利影

响。

(十) 存货跌价的风险

报告期期末，公司存货主要包括原材料、在产品、半成品、库存商品和发出商品，其账面余额为 20,195.54 万元，其跌价准备为 2,495.99 万元，占存货账面余额的比例相对较高。公司采用以销定产的生产模式，产品从原材料采购至客户验收对账需要经历一定周期，同时公司还需要保留一定数量的原材料备货以备客户临时或加急需求。由于下游行业技术迭代速度较快，若未来产品更新换代加速、市场需求不及预期、库龄结构恶化，可能导致存货发生跌价损失，对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

(十一) 应收账款坏账损失风险

报告期期末，公司应收账款账面余额为 34,535.56 万元，总体规模随业务扩张持续增长。若未来宏观经济、行业景气度发生不利变化，或主要客户经营状况、信用水平出现恶化，可能导致应收账款回款不及预期、发生坏账损失，从而对公司盈利能力和现金流稳定性产生不利影响。

(十二) 新增固定资产及项目投入带来大额费用支出增加的风险

为扩大产能、升级技术与布局新产品线，公司近年来持续推进生产基地建设、产线升级及研发相关固定资产投资，未来随着在建工程陆续转固、产能进一步扩张，将带来大额折旧摊销、运营维护及人工等新增费用支出。若未来市场需求发生重大不利变化、行业竞争加剧导致产品毛利率下滑，或新增产能无法及时有效消化、产出效益不及预期，上述大额费用支出将直接增加公司经营压力，对公司盈利能力、财务状况及经营业绩产生一定不利影响。

(十三) 综合竞争力与境外龙头探针卡厂商存在差距

目前，探针卡行业由境外厂商主导。探针卡行业前十大厂商多年来均为境外厂商，合计占据了全球约 80% 的市场份额。境外龙头探针卡厂商成立时间久、进入市场早、经营规模大、研发投入高，并面向全球市场提供服务，具有市场竞争优势。公司在技术实力、产品稳定性以及全球服务能力等方面较境外龙头厂商仍存在不同程度的差距。如果公司不能有效提升自身综合竞争力、提升产品品质或在境外拓展业务的过程受到政策、法律法规、政治等方面的限制，则将对公司拓展客户、扩大经营规模等方面带来不利影

响。

(十四) 半导体产业周期性波动

探针卡行业与半导体行业的变动直接相关，例如芯片设计厂商的新产品研制、量产产品的出货，晶圆制造厂商的产能及稼动率等。半导体行业具有周期性，其特点是产品供需波动较大，主要和产品成熟与技术突破的更迭、产能周期以及宏观经济走势有关。当行业处于下行周期时，终端需求疲软可能会对公司的收入、毛利率产生不利影响，此外持续的低迷可能引致一个或多个客户的偿付能力受损，进而影响公司回收应收账款的能力。因行业周期性低迷的时间、长度和严重程度难以预测，如果公司未能做好计划或及时采取应对措施，则将对生产经营产生不利影响。

(十五) 探针卡行业市场规模相对较小

根据 QYResearch 估算，2025 年全球半导体探针卡行业市场规模为 36.40 亿美元，2025 年中国半导体探针卡市场规模约 6.15 亿美元（占全球 16.9%），总体规模相对较小。报告期内，公司营业收入主要来自于境内客户。

目前，半导体行业已经形成诸多成熟的细分市场，除少数设备、材料全球市场规模超过 100 亿美元，绝大多数细分市场规模在 10-60 亿美元之间。此外，我国半导体行业近年快速发展，国产替代的进程不断加速，细分市场发展潜力巨大。尽管如此，如果境内探针卡市场未能随我国半导体自主可控的趋势同步发展，或者因地缘政治、进出口限制等因素导致公司境外业务拓展存在困难，将使公司面临市场空间较小或业务拓展受限的风险。

(十六) 国际贸易摩擦风险

目前，公司境内主要客户存在受国际贸易摩擦不同程度的影响，同时公司从境外供应商或其境内分支机构采购部分原材料和设备。随着中国在全球制造业产业链地位的不断提高，部分国家已经或未来可能采取提高关税、限制进出口等贸易保护措施，如果相关措施对公司主要客户产生更为实质的不利影响，或涉及公司主要原材料或主要设备，将可能对公司生产经营产生一定不利影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，强一股份不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年，公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

| 主要会计数据 | 2025 年度 | 2024 年度 | 本期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------|------------|---------------|
| 营业收入 | 101,210.45 | 64,136.04 | 57.81% |
| 利润总额 | 44,156.24 | 25,756.39 | 71.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,492.49 | 23,309.70 | 69.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,112.02 | 22,704.92 | 72.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,475.74 | 27,967.16 | 37.57% |
| 主要会计数据 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 本期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 406,604.57 | 112,259.80 | 262.20% |
| 总资产 | 446,146.29 | 127,665.90 | 249.46% |

公司主要财务指标如下表所示：

| 主要财务指标 | 2025 年度 | 2024 年度 | 本期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| 基本每股收益（元/股） | 4.06 | 2.40 | 69.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 4.06 | 2.40 | 69.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 4.03 | 2.34 | 72.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 29.92 | 23.30 | 增加 6.62 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 29.63 | 22.70 | 增加 6.93 个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 13.06 | 12.25 | 增加 0.81 个百分点 |

2025 年度，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

（一）公司营业收入、经营活动产生的现金流量净额分别同比增长 57.81%、37.57%，主要得益于公司把握半导体行业景气周期与国产替代机遇，实现了营业收入和经营现金流快速增长。

（二）公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 71.44%、69.43%和 72.26%，主要原因系：1、半导体行业需求持续扩容，带动公司营业收入快速增长，贡献了业绩增量；2、产品结构持续优化，成熟 2D MEMS 探针卡渗透率不断提升，推动整体盈利水平改善。

（三）公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、

扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增长 249.46%、262.20%、69.17%、69.17%、72.22%，主要原因系 2025 年公司完成首次公开发行股票，募集资金到账使得股本及资本公积同比大幅增加。

六、核心竞争力的变化情况

公司聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售，拥有自主 MEMS 探针制造技术并能够批量生产、销售 MEMS 探针卡，核心竞争优势主要体现在核心技术优势、人才优势、客户优势、产能优势以及地域优势。报告期内，公司核心竞争力不存在重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

2025 年度，公司持续保持较高水平的研发投入，研发费用为 13,218.96 万元，较上年同期增长 68.31%。截至 2025 年 12 月末，公司研发人员人数 175 人，占公司员工总数的比重为 18.78%。公司建立了完善的知识产权管理体系，实现对知识产权的保护。2025 年公司共申请发明专利 95 件，获得授权发明专利 11 件。截至 2025 年底，公司累计获得各类知识产权 195 项，其中发明专利 78 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元

| | |
|----------------|------------|
| 一、募集资金总额 | 275,605.51 |
| 其中：超募资金金额 | 102,646.18 |
| 减：发行费用 | 22,959.33 |
| 二、募集资金净额 | 252,646.18 |
| 加：尚未置换及支付的发行费用 | 1,159.47 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 253,805.65 |

公司 2025 年募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规

的规定，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

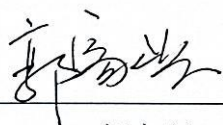
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际控制人、董事和高级管理人员持有的股份不存在质押、冻结及减持的情形。


十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于强一半导体（苏州）股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：


郭家兴


张宇辰

